

金达科技股份有限公司

关于公司预计 2026 年度银行授信暨资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2026 年度预计向银行授信额度及抵押情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟以信用及资产抵押的方式向银行申请总额不超过 5000 万元（含）的综合授信额度。

公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。

二、审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2026 年度银行授信暨资产抵押的议案》。议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

《金达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

金达科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日